# 成都华微

## 公司基本资料

公司名称: 成都华微电子科技股份有限公司

英文名称: Chengdu Sino-Microelectronics Technology Co., Ltd.

A股代码: 688709

A股简称: 成都华微

A股扩位简称: 成都华微

曾用名: --

B股代码: --

B股简称: --

H股代码: --

H股简称: --

证券类别: 上交所科创板A股

所属东财行业: 电子设备-半导体-集成电路

上市交易所: 上海证券交易所

所属证监会行业: 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

总经理: 王策

法人代表: 王策

董秘: 李春妍

董事长: 李烨

证券事务代表: 周文明,蔡进

独立董事: 李越冬,贺正生,刘莉萍

联系电话: 028-85136118

电子信箱: investors@csmsc.com

传真: 028-85187895

公司网址: --

办公地址: 成都市高新区益州大道中段1800号1栋、成都市双流区双华路288号

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋22-23层2201号、2301号

区域: 四川

邮政编码: 610096

注册资本(元): 6.368亿

工商登记: 91510100720342949A

雇员人数: 953

管理人员人数: 16

律师事务所: 北京市中伦律师事务所

会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司简介: 成都华微电子科技股份有限公司专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售,以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向,主要产品涵盖特种数字及模拟集成电路两大领域,其中数字集成电路产品包括以可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)为代表的逻辑芯片、存储芯片及微控制器等,模拟集成电路产品包括数据转换(ADC/DAC)、总线接口、电源管理及放大器等,产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。  
 公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业,连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA国家科技重大专项,“十三五”高速高精度ADC国家科技重大专项、高速高精度ADC国家重点研发计划,智能异构可编程SoC国家重点研发计划,是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。在技术与研发方面,公司高度重视对产品及技术的研发投入,近三年累计研发投入占累计营业收入的比例超过60%。公司已形成了一系列核心技术成果,整体技术储备处于特种集成电路设计行业第一梯队,拥有多项发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等,在大规模FPGA及CPLD、高精度ADC等领域相关技术处于国内领先地位。公司高度重视研发人才的引进和培养,目前研发人员占员工总数的比例超过50%,形成了较为完善的研发体系及人才梯队。  
 在产品方面,公司同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力,产品覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品,具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。公司高度重视产品从研发到交付各道环节的质量控制,建立了特种集成电路检测线和完善的质量控制体系,拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS、国防科技工业实验室认可委员会DiLAC认证的国家级检测中心,具有较为完备的集成电路成品测试能力。

经营范围: 设计、开发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务;货物及技术进出口;信息系统集成;公共安全技术防范工程、通讯工程的设计及施工(涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营);开发、销售软件;(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 发行相关信息

保荐机构: 华泰联合证券有限责任公司

主承销商: 华泰联合证券有限责任公司

成立日期: 2000-03-09

上市日期: 2024-02-07

发行市盈率(倍): 37.04

网上发行日期: 2024-01-29

发行方式: 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售

每股面值(元): 1

发行量(股): 9560万

每股发行价(元): 15.69

发行费用(元): 8404万

发行总市值(元): 15.00亿

募集资金净额(元): 14.16亿

首日开盘价(元): 21.33

首日收盘价(元): 19.69

首日换手率: 68.31%

首日最高价(元): 24.88

网下配售中签率: 0.03%

定价中签率: 0.06%